

연수 제안서

연구 분야	압전 소재 및 소자 개발
연구 과제명	TGG 기반 Hard 압전 재료 및 초음파트랜스듀서 개발
연수 제안 업무	소재, 공정, 소자 개발
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2021.07.01. ~2022. 06. 30</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 압전 트랜스듀서 설계 및 개발- 하이브리드 압전 에너지 하베스팅 기술 개발- 광대역 압전 에너지 하베스팅 기술 개발- 결정립 배향용 압전 소재 공정 개발	
소속 부서 : 전자재료연구센터	
연수 책임자 : 강종윤	